

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2023-025

安徽耐科装备科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023 年半年度本公司募集资金使用情况为：（1）本报告期直接投入募集资金项目 525.10 万元；（2）本报告期以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 54,600.00 万元，理财产品到期赎回 26,500.00 万元。公司本报告期募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 132.82 万元，截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额为 68,633.27 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 49,300.00 万元，募集资金专户余额合计为 19,333.27 万元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	47,825.55

项目	金额
减：本报告期投入募集资金总额	525.10
其中：本报告期以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	-
本报告期直接投入募集资金项目	525.10
减：本报告期以闲置资金购买理财产品	54,600.00
加：本报告期闲置资金购买理财产品到期赎回	26,500.00
加：本报告期收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	132.82
2023年6月30日募集资金余额	68,633.27
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	49,300.00
2023年6月30日募集资金专户余额	19,333.27

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年11月2日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	7,702.48
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	3,827.83
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	7,492.93
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	100.86
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	209.17
合计		19,333.27

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用

报告期内，本公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收 益率	投资收 益(万 元)	是否 赎回
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	11,200.00	2022/12/13	2023/6/30	1.4%-3.5%	-	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225507	31,000.00	2023-1-3	2023-10-9	1.0%-3.72%	-	否

受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收 益率	投资收 益(万 元)	是否 赎回
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 448 期 B 款	10,000.00	2022/12/13	2023/10/10	1.4%-3.5%	-	否
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225505	8,300.00	2023-1-3	2023-3-31	1.4%-3.38%	67.05	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202225506	7,000.00	2023-1-3	2023-6-30	1.4%-3.43%	47.79	是
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	对公结构性存款 202330990	8,300.00	2023-4-3	2023-9-30	1.4%-3.43%	-	否
合计		75,800.00					

截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 49,300.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司结合半导体行业发展前景以及发展规划和战略,通过调整优化半导体封装装备新建项目内部投资结构,在不改变项目实施的条件下,充分利用新建厂房用地,以实现公司和全体股东利益的最大化。于2023年6月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,具体内容详见公司已于2023年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2023-021)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

特此公告

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				70,133.13		本报告期投入募集资金总额					525.10	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					1,850.43	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
半导体封装装备新建项目	否	19,322.00	19,322.00	19,322.00	430.14	1,655.37	-17,666.63	8.57%	2024 年	不适用	不适用	否
先进封装设备研发中心项目	否	3,829.00	3,829.00	3,829.00	10.38	10.38	-3,818.63	0.27%	2024 年	不适用	不适用	否
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	否	8,091.00	8,091.00	8,091.00	84.58	184.68	-7,906.32	2.28%	2024 年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,804.42	7,804.42	7,804.42	-	-	-7,804.42	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	39,046.42	39,046.42	39,046.42	525.10	1,850.43	-37,195.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为49,300.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司结合半导体行业发展前景以及发展规划和战略，通过调整优化半导体封装装备新建项目内部投资结构，在不改变项目实施的条件下，充分利用新建厂房地，以实现公司和全体股东利益的最大化。于2023年6月16日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，具体内容详见公司已于2023年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-021）。